



(South Korea)

EVG announces new NanoCleave layer release technology that revolutionizes 3D integration from advanced semiconductor packaging to miniaturization – January 29, 2024

EVG, 첨단 반도체 패키징에서부터 소형화까지 3D 집적 혁신하는 NanoCleave 레이어 릴리즈 신기술 발표

- 기자명 KIPOST
- 입력 2024.01.30 10:35
- 수정 2024.01.31 16:35
- 댓글 0



반도체 웨이퍼 본딩 및 리소그래피 장비 전문업체인 EV Group(이하 EVG)은 반도체 제조를 위한 혁신적인 레이어 릴리즈 기술인 NanoCleave™를 출시한다고 30일 밝혔다.

NanoCleave 기술은 첨단 로직, 메모리, 전력 반도체 프론트엔드 공정은 물론 첨단 반도체 패키징에 초박형 레이어 적층을 가능하게 한다. NanoCleave는 반도체 전 공정에 완벽하게 호환되는 레이어 릴리즈 기술로 실리콘을 투과하는 적외선 레이저를 사용하는 것이 특징이다. 또 특수 조성된 무기 박막과 함께 사용할 경우 나노미터의 정밀도로 초박형 필름이나 레이어를 실리콘 캐리어로부터 적외선 레이저로 분리할 수 있게 해준다.

NanoCleave는 EMC(epoxy mold compounds)와 재구성 웨이퍼(reconstituted wafer)를 사용하는 팬아웃 웨이퍼 레벨 패키징(FoWLP)에서부터 3D SIC(3D Stacking IC)의 인터포저 같은 첨단 패키징 공정에서 실리콘 웨이퍼 캐리어 사용을 가능하게 한다.

또 고온 공정에도 적용할 수 있어 3D IC 및 3D 순차 집적 애플리케이션에서 완전히 새로운 공정 플로우를

구현할 수가 있다. 이는 실리콘 캐리어 상의 초박형 레이어까지도 하이브리드 및 퓨전 본딩이 가능해 3D 및 이중 집적에 혁신을 가져다줄 뿐만 아니라 차세대 트랜지스터 집적화 설계에서 필요한 레이어 이송을 가능하게 한다.

EVG는 코엑스에서 1월 31일부터 2월 2일까지 개최되는 SEMICON 코리아 2024 전시회에 참가하여 NanoCleave 신기술을 소개한다.

저작권자 © KIPOST(키포스트) 무단전재 및 재배포 금지

출처 : KIPOST(키포스트)(<https://www.kipost.net>)

<https://www.kipost.net/news/articleView.html?idxno=316196>